

檔 號：

保存年限：

# 台灣發明協會 函

機關地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立臺南護理專科學校

發文日期：中華民國113年10月31日

發文字號：台發協字第1130010022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2025台灣發明協會國際發明展參展日期表(ATTCH6 0010022A00\_ATTCH6.pdf)

主旨：台灣發明協會 公告 2024歲末暨2025年度國際發明展盛會參展日期表

說明：

一、敬邀貴校師生2025年由台灣發明協會率團參展之國際發明競賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加，享譽國際、為台爭光。

二、各展報名表 洽詢專線02-6605-7626 吳秘書

報名網址：[www.tia-tw.com](http://www.tia-tw.com)

email：[tia7626@yahoo.com.tw](mailto:tia7626@yahoo.com.tw)

台灣發明協會官方好友 LINE ID:@123atruj

正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏

國立臺南護理專科學校



裝

訂

線



學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、大同技術學院、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、財團法人中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、東方學校財團法人東方設計大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、高苑科技大學附設專科進修學校、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、大漢學校財團法人大漢技術學院、中華台北著作權人協會

副本：



張家菊 會長

裝

線

# 台灣發明協會

## Taiwan Invention Association

地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段一號4樓之11

4F.-11, No. 1, Sec. 1, Chongyang Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241608, Taiwan (R.O.C.)

Tel:02-6605-7626 E-mail: tia7626@yahoo.com.tw http://www.tia-tw.com

展別	參展日期	報名截止
 Seoul International Invention Fair <b>韓國首爾 國際發明展</b>	<b>2024. 11. 27~11. 30</b>	<b>10 月</b>
 inventions Hong Kong <b>香港亞洲創新 發明展</b>	<b>2024. 12. 05~12. 06</b>	<b>11 月</b>
 IIFME International Invention Fair in the Middle East العرض الدولي للابتكار في الشرق الأوسط <b>中東科威特 國際發明展</b>	<b>2025. 02. 16~02. 19</b>	<b>12 月</b>
 inventions Geneva <b>瑞士日內瓦 國際發明展</b>	<b>2025. 04. 09~04. 13</b>	<b>2 月</b>

 <p><b>美國矽谷 國際發明展</b></p>	<p><b>2025.07 月</b></p>	<p><b>5 月</b></p>
 <p><b>金磚國家國際 線上發明大賽</b></p>	<p><b>2025.10 月</b></p>	<p><b>9 月</b></p>



台灣發明協會/中華台北著作權人協會

團長 **張家菊** 敬邀

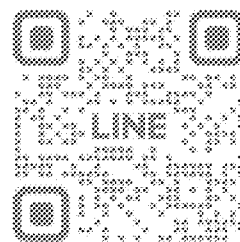
**繳交參展資料明細單：**

以下資料請以電子檔文件，文字部分以 word 檔建檔，照片圖檔請以 jpg 檔文件，謝謝。



01. 已填妥之報名表(請詳細填寫完整)
02. 切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章後掃描回傳)
03. 參展品專利證書影本檔案(若尚在申請中請檢附專利申請收據)
04. 參展品照片檔案(每件作品建議提供 2~3 張)

@123atruj



TIA台灣發明協會參展團

報名日期：即日起接受報名

聯絡地址：(241-608) 新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626 # 323

E-mail : tia7626@yahoo.com.tw

• 報名截止日前需先將訂金 **20,000 元**或全額匯入帳戶，如逾期，可能喪失報名資格。

• 電匯資料：**新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行** 帳號：**0310-10-100304-3**

戶名：**社團法人台灣發明協會**